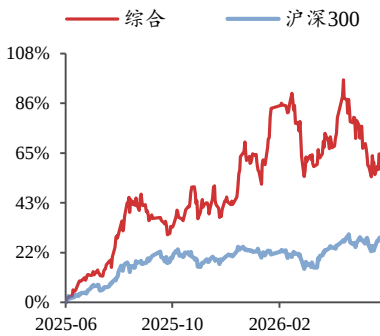


综合

2026 年 06 月 21 日

投资评级：看好（维持）

行业走势图



数据来源：聚源

相关研究报告

《800VDC 预计成为数据重心架构发展必然趋势，功率半导体开启 AI 新周期——行业周报》-2026.6.14

《Nebius 将被纳入纳斯达克 100 指数，智谱发布 GLM-5.2 回应 Mythos 下架事件——行业周报》-2026.6.14

《AI 驱动变革，云计算进入新一轮扩张周期——港股行业深度报告》-2026.6.9

光互联产业链现扩产潮，键合设备厂商披露大额订单

——行业周报

初敏（分析师）

chumin@kysec.cn

证书编号：S0790522080008

叶彬慧（联系人）

yebinhui@kysec.cn

证书编号：S0790124070053

● AI 硬件：CPO/NPO 空间打开，光芯片产业链加速扩产

光互联升级加速，价值链加速 InP（磷化铟）光芯片及封测上移：Trend

测 CPO/NPO 市场将由 2025 年约 1 亿美元增长至 2030 年超 390 亿美元，但 2028—2029 年才有望明显加速，且可插拔光模块仍将长期并存，说明产业正由传统可插拔，向着 NPO/CPO 等 XPO 方案稳步推进。光互联产业链巨头纷纷扩产，隐含供应短缺正逐步向上游延伸，近期 Coherent、Nokia、JX、IQE/Tower、东山精密等相继扩产，覆盖 InP 衬底、外延、光芯片、封测及模块全链条，表明 AI 光互联已从需求预期进入资本开支落地阶段。我们认为，投资主线正从下游光模块整机上移至 InP 材料、光芯片、硅光 PIC 及先进封测等核心瓶颈环节。

● 半导体设备：设备厂商涨价周期开启，键合设备厂商披露大额订单

受益于 AI 算力芯片需求持续增长，全球半导体设备进入量价齐升的上升周期，SEMI 预计 2026 年全球半导体制造设备销售额将达到 1450 亿美元，2026 年第一季度全球设备出货金额达 365.5 亿美元，同比增长 14%，其中中国台湾和韩国地区增速领跑。当前行业面临严重的供给约束，关键零部件交期大幅延长，设备厂商定价权显著提升，全球半导体设备正式进入涨价周期。东京电子(TEL)明确提出成本联动、急单溢价、新品迭代三大调价策略，目标在 1-2 年内将整体毛利率提升至 50%以上，多家设备供应商已跟进提价，SK 海力士正在评估供应商的涨价要求。在细分领域，HBM 产能扩张带动高端 TCB 热压键合设备需求爆发，韩美半导体、韩华半导体、ASMPT 近期均获得来自 SK 海力士等头部厂商的大额订单。

● 投资建议：

AI 硬件：建议关注“光互联”上游公司，如：Lumentum、Tower Semiconductor、Coherent、Micron Technology。建议关注 PC 上游配套，如：Micron Technology。建议关注半导体设备标的，如：ASMPT。

风险提示：软件及产品推出不及预期，产能及供应链风险，监管政策变动，宏观经济增长放缓，地缘政治风险。

目录

1、 AI 硬件：CPO/NPO 需求升温，光芯片全链条扩产提速.....	3
1.1、 Trend	
1.2、 多家光芯片上下游巨头纷纷扩产，隐含光芯片产业需求火爆	4
2、 半导体设备：设备厂商涨价周期开启，键合设备厂商披露大额订单	4
2.1、 供给紧缺定价权上移，设备厂商涨价周期开启	4
2.2、 高端键合设备需求旺盛，头部厂商获多笔大额订单	6
3、 港股周度更新	7
4、 投资建议	10
5、 风险提示	10

图表目录

图 1： 全球半导体设备销售势头强劲，预计 2026 年销售额超 1400 亿美元	5
图 2： 本周恒生指数（2026.06.15-2026.06.18）在全球主要市场中跌幅较大（单位：%）	7
图 3： 本周（2026.06.15-2026.06.18）港股恒生港股通高股息率板块跌幅较大（%）	7
图 4： 本周（2026.06.15-2026.06.18）公用事业类、金融类跌幅较小（%）	7
图 5： 2026 年 5 月以来港股通当日买入成交净额有所波动（亿元）	8
图 6： 恒生沪港通 AH 溢价指数或已触底.....	9
图 7： OpenRouter 的 token 调用量持续提升	9
表 1： 2026Q1 全球半导体设备出货量达到 365.5 亿美元/同比增长 14%.....	5
表 2： 本周（2026.06.15-2026.06.18）港股通头部活跃个股资金流向信息技术等标的（仅计算前十大活跃个股明细） ...	8

1、AI 硬件：CPO/NPO 需求升温，光芯片全链条扩产提速

1.1、Trend

6 月 15 日，Trend

负载的快速增长正推动 AI 数据中心向更高功耗、更高机架密度及更大集群规模演进。随着数据传输成为主要能耗来源，云服务提供商(CSP)已将互连技术提升至与计算硬件同等重要的地位。互连架构现已成为决定 AI 工厂扩张、能效优化及供应链管理的核心战略要素。据此，Trend

从 2025 年的约 1 亿美元大幅扩张，至 2030 年将突破 390 亿美元 Trend

封装光学(CPO)与近封装光学(NPO)市场将从 2025 年的约 1 亿美元大幅扩张，至 2030 年将突破 390 亿美元。

Trend

加速，并且可插拔光模块到 2030 年仍有接近 260 亿美元市场，隐含的意思在于“CPO 并非马上爆发”，而是“产业正在逐步由传统可插拔逐步过渡到 XPO 方案”。

我们认为，光互联的“升级”正在有序、稳步地推进过程中，而 XPO 之中，NPO 的技术难度略低于 CPO，有望更早落地，因此将会更加利好 NPO 相关的供应链公司。另，过去光通信投资更偏向下游光模块整机（例如 800G、1.6T 模块出货量）。但这批新闻说明，AI 光互联的核心矛盾正在上移，从“光模块”上移到“InP/光芯片/硅光/封测”。

第一，InP 衬底和外延成为最上游稀缺资源。

JX 扩产 7-10 倍、IQE 与 Tower 签多年协议，说明 InP 不再只是传统电信/数通材料，而是进入 AI 数据中心关键材料框架。IQE 与 Tower 的协议明确覆盖 AI 数据中心光连接，应用包括 200Gbps/lane 可插拔收发器、下一代 400Gbps/lane 调制器、数据中心光路交换等，并设置最低采购和供应承诺。

第二，InP 光芯片比传统光模块更具弹性。

Coherent 这次扩的是 6 英寸 InP 工厂，不是简单扩模块产线。对投资而言，价值量更可能集中在激光器、探测器、外置光源、CW Laser、EML 等核心光芯片环节。Coherent、Lumentum 这类厂商的逻辑因此强化。

第三，硅光 PIC 和 III-V 异质集成的重要性上升。

Tower 与 IQE 的协议本质上说明，硅光平台并不只是“硅晶圆代工”，未来要把 InP 高性能组件纳入硅光平台，服务 200G/lane、400G/lane 和 OCS 等下一代方向。这对 Tower 的意义较大：它的 SiPho 故事从“产能展望”进一步变成“供应链绑定和量产准备”。

第四，光子芯片封装测试是潜在被低估环节。

Nokia 公告提到，其 Allentown 工厂是美国少数具备将光子芯片 ATP 成光模块能力的设施之一，扩产后产能最高提升 10 倍，并预计 2026 年三季度末形成商业可用产能。这说明未来 CPO/NPO/硅光放量时，瓶颈不只是芯片，还包括光电封装、测试、耦合、良率和可制造性。

1.2、多家光芯片上下游巨头纷纷扩产，隐含光芯片产业需求火爆

近期，全球 AI 光互联产业链连续释放扩产信号，从上游 InP 衬底、外延片，到中游 InP 芯片制造、光子芯片封装测试，再到下游高速光模块，均出现明显的资本开支加速迹象。

据 Coherent 公司官网，6 月 16 日，Coherent 宣布已签署意向书，拟根据美国《芯片与科学法案》获得美国商务部最高 5000 万美元的直接资金支持，用于扩建其位于德克萨斯州谢尔曼的 6 英寸 InP 半导体制造工厂。该工厂是全球领先的 InP 制造基地之一，扩建有望进一步强化 Coherent 在 AI 光通信核心光芯片环节的产能优势。

据 Nokia 公司官网，Nokia 宣布将在美国宾夕法尼亚州 Allentown 扩建光子芯片的先进测试与封装能力，重点将光子芯片进一步封装成可用于 AI 及通信基础设施的光模块。Nokia 表示，该基地是美国少数具备此类能力的设施之一，扩产完成后，相关产能最高可提升至当前水平的 10 倍，预计将在 2026 年三季度末形成商业可用产能。

据 JX Advanced Metals 公司官网，6 月 16 日，全球 InP 衬底双寡头之一的日本 JX Advanced Metals 宣布，计划在未来四年内最高投资 1200 亿日元，用于扩大 InP 衬底产能。若叠加此前已披露的相关投资，公司在 InP 产能建设方面的总投资规模将达到约 1500 亿日元。公司预计，上述投资将推动其 InP 衬底产能提升至原有水平的 7 至 10 倍。

据 Semiconductor Today，6 月 15 日，IQE 与 Tower Semiconductor 达成多年期 InP 外延片供应协议，以支持 Tower 硅光平台在 200Gb/通道可插拔收发器、下一代 400Gb/通道调制器以及光路交换等应用方向的量产扩展。根据协议，Tower 将在首年作出最低采购承诺，IQE 则提供相应供应保障；后续双方还将继续设置最低采购量安排。

据证券时报，6 月 16 日晚间，东山精密公告称，公司同意全资子公司索尔思光电及其子公司在常州布局光芯片及高速光模块扩建项目，项目总投资额达 12 亿美元，资金来源为公司自筹。该项目显示国内高速光模块及光芯片厂商也在加快面向 AI 数据中心需求的产能布局。

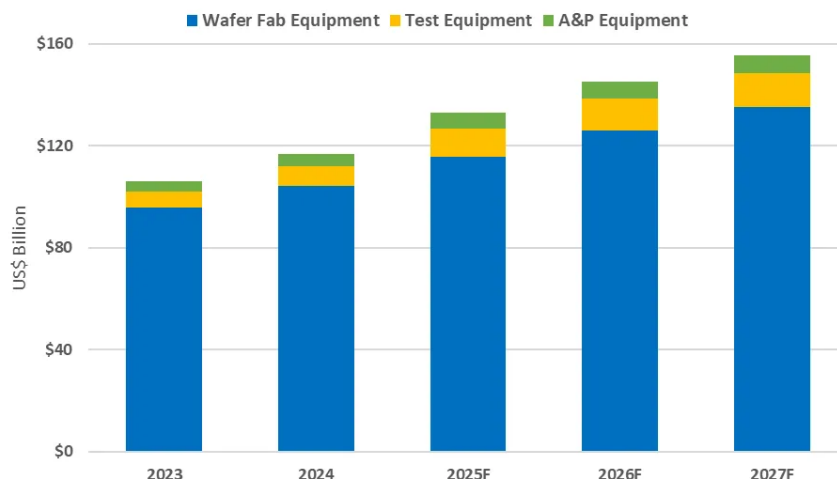
我们认为，短期内多家巨头同时宣布有关光通信的扩产扩建，意味着 AI 光互联已经从“需求预期阶段”进入“全球头部厂商资本开支落地阶段”。但更值得注意的是，扩产已经不再是单点发生，而是覆盖了“衬底、外延、光芯片、封测、模组”整个完整的产业链，说明产业链正在为 2026-2028 年 AI 数据中心光互联需求做前置产能准备，也说明了光互联产业总体供不应求、厂商纷纷扩产的现状。

2、半导体设备：设备厂商涨价周期开启，键合设备厂商披露大额订单

2.1、供给紧缺定价权上移，设备厂商涨价周期开启

半导体设备进入新上升周期，上游定价逻辑有望改写。受益于高端逻辑电路、存储器以及先进封装渗透，SEMI 预计全球半导体制造设备销售额（W 试）将从 2025 年的 1330 亿美元增至 2026 年的 1450 亿美元；2026Q1 全球半导体设备出货量达到 365.5 亿美元/同比增长 14%，台湾、韩国增速持续领跑。基于数据中心 AI 算力芯片需求增长，全球 IDM、扩产，全球半导体设备环节将成为这一轮超级扩产周期的主要瓶颈，有望迎来量价齐升周期。

图1：全球半导体设备销售势头强劲，预计 2026 年销售额超 1400 亿美元



资料来源：SEMI

表1：2026Q1 全球半导体设备出货量达到 365.5 亿美元/同比增长 14%

地区	2026Q1	2025Q4	2025Q1	环比	同比
欧洲	0.95	0.74	0.87	28%	9%
日本	2.16	2.82	2.18	-24%	-1%
北美	3.28	3.09	2.93	6%	12%
韩国	8.93	7.08	7.69	26%	16%
中国台湾	8.77	7.44	7.09	18%	24%
中国大陆	10.99	13.13	10.26	-16%	7%
世界其他地区	1.48	1.97	1.03	-25%	43%
总计	36.55	36.27	32.05	1%	14%

数据来源：SEMI、开源证券研究所

（1）元件面临严重供给约束，设备订单交期延长。由于晶圆厂产能优先保证高利润的数据中心算力芯片供给，半导体测试设备关键零部件的采购形势急剧恶化。以测试设备为例，包括其中用于运行测试系统的据《电子》杂志报道，一家半导体检测设备制造商最近与三星电子签署了一份价值超过 100 亿韩元的供货合同，但由于零部件短缺，被迫将交货时间推迟三个月。以全球第二大半导体设备商 TEL（东京电子）为例，TEL 透露当前客户询热情高，每

周均收到加急出货申请，目前订单体量已填满下半年产能，预计行业景气具备持续性。

(2) 设备上游供应链议价权提升，全球设备正式进入涨价周期。半导体设备供应商长期议价能力较低，新设备导入需面临来自主要客户采购体系的压力，例如年度成本削减要求、反复的价格谈判、延迟验收以及订单取消等；在复购订单中晶圆厂通常会遵循供应链管理惯例，要求供应商持续降价。尤其是在存储器市场低迷时期，晶圆厂削减资本支出时，设备供应商为了确保订单、维持市场份额和保持生产线利用率而接受降价要求。而得益于 AI 产能的持续短缺，台积电、三星、美光等头部大厂向上游设备厂商提出明确的加单、催交、锁产能要求，有望推动全球半导体设备供需逻辑反转。TEL 当前订单饱满，为应对成本上涨、客户催单明确提出将合理推进设备涨价，预计在 1-2 年内将整体毛利率提升至 50% 以上/提升约 5pct，包括三大调价场景：

I. 成本联动涨价：针对材料、人工成本等固定成本上涨，和客户充分沟通后基于上涨幅度同步调高全线产品价格；

II. 急单加急溢价：针对当前客户紧急加单需求，定向提价提供缩短交付周期的效率增值服务。

III. 新品迭代提价：结合产品价值执行差异化定价，对于能显著提升客户生产良率、效率的高毛利设备，在新品迭代节点同步提升定价。

行业设备提价获多家供应商验证。根据 ET News，SK 海力士的几家一级设备供应商要求将供货价格上调 3-4%，海力士已要求相关供应商提交价格调整的证明文件，响应供应商提出的涨价要求，目前正在评估中。~~资本开支~~支撑下设备中长期上行催化充足，半导体设备紧缺走向现实推动产业定价权上移涨价周期已经启动，设备厂商稼动率抬升叠加产品提价，规模效应下盈利有望超预期。

2.2、高端键合设备需求旺盛，头部厂商获多笔大额订单

韩美半导体：公司于 6 月 8 日宣布，已收到 SK 海力士价值 442 亿韩元的订单，为其提供用于 HBM4 生产的 TCBonder 设备。该设备型号为 TCBonder4.5Griffin，预计将于 9 月初交付。

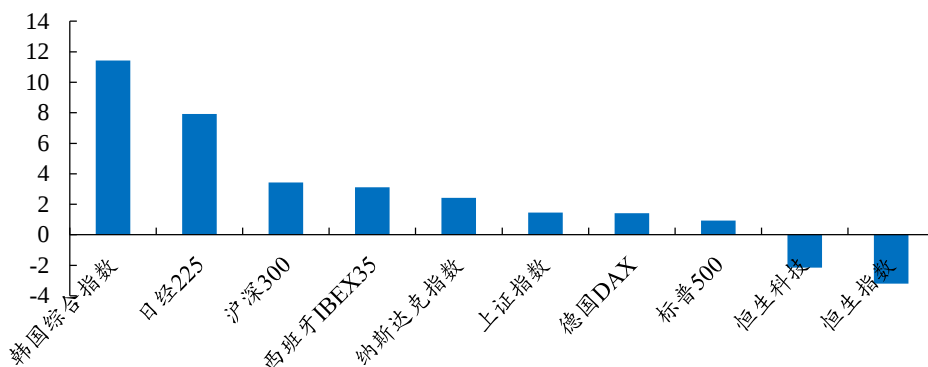
韩华半导体：公司旗下第二代芯片转晶圆混合键合设备型号 SHB2Nano，已于今年 4 月进驻 SK 海力士的一条生产线。此次交付的设备采用集群组合形式，而非独立的混合键合单机，目前这套系统正处于质量评估与性能优化阶段。该公司还从 SK 海力士手中拿到了用于 HBM4 产品生产的 TCB 新增订单。

ASMPT：6 月 8 日宣布已从一家全球领先的集成器件制造商（IDM）获得八台用于芯片到晶圆（C2W）应用的 TCB 热压键合设备的续订订单，这些设备将支持该 IDM 生产先进的客户端和数据中心 CPU。

3、港股周度更新

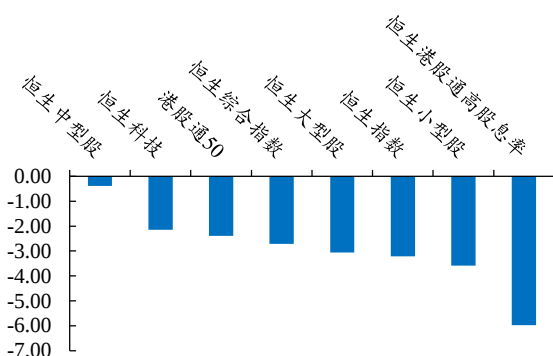
本周恒生指数下跌 3.21%，在全球主要市场中跌幅较大，从成分上看，物业服务及管理、地产类等跌幅居前，恒生科技本周下跌 2.14%。

图2：本周恒生指数(2026.06.15-2026.06.18)在全球主要市场中跌幅较大(单位：%)



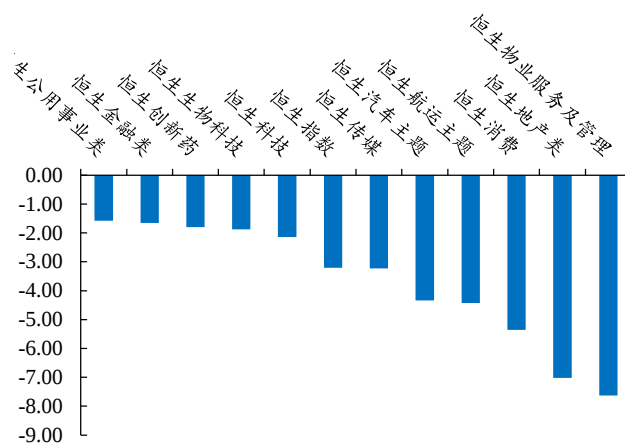
数据来源：Wind、开源证券研究所

图3：本周(2026.06.15-2026.06.18)港股恒生港股通高股息率板块跌幅较大(%)



数据来源：Wind、开源证券研究所

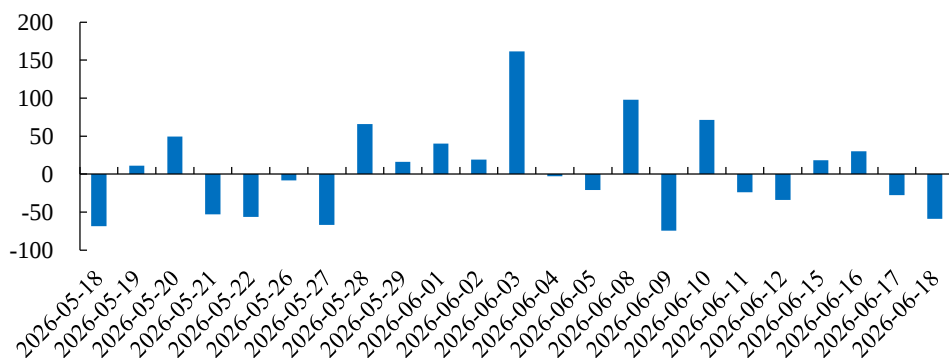
图4：本周(2026.06.15-2026.06.18)公用事业类、金融类跌幅较小(%)



数据来源：Wind、开源证券研究所

本周港股通成交净额为流出 38.3 亿元，环比回落，从头部活跃个股交易层面来看，建滔积层板(+82.3 亿港元)、建滔集团(+54.5 亿港元)、智谱(+41.3 亿港元)资金净流入居前。

图5：2026 年 5 月以来港股通当日买入成交净额有所波动（亿元）



数据来源：Wind、开源证券研究所

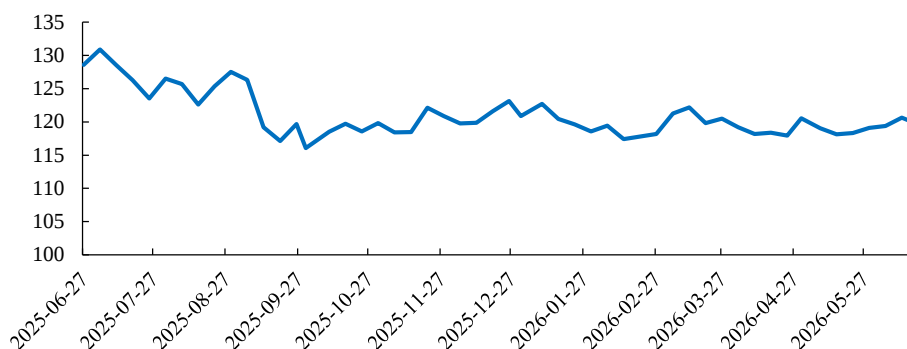
表2：本周（2026.06.15-2026.06.18）港股通头部活跃个股资金流向信息技术等标的（仅计算前十大活跃个股明细）

股票代码	股票名称	成交净买入（亿港元）	港股通持股数占总股本比例
1888.HK	建滔积层板	82.3	11.1%
0148.HK	建滔集团	54.5	12.1%
2513.HK	智谱	41.3	2.4%
0981.HK	中芯国际	29.7	31.2%
1347.HK	华虹宏力	10.0	21.5%
6869.HK	长飞光纤光缆	4.2	49.2%
3986.HK	兆易创新	-0.5	21.0%
3690.HK	美团-W	-5.9	21.1%
9992.HK	泡泡玛特	-7.3	25.8%
0883.HK	中国海洋石油	-32.0	22.6%
0700.HK	腾讯控股	-55.4	11.6%
9988.HK	阿里巴巴-W	-84.4	11.0%

数据来源：Wind、开源证券研究所

本周恒生沪港通 AH 溢价指数为 119.7，环比有所下降，AH 股溢价或已触底。考虑到该指数成分中金融行业权重超 50%，能源行业权重超 15%，背后或更多反映对红利概念有需求的资金特征。随着后续更多 A 股科技类标的赴港上市，或带动港股板块的“成长性溢价”持续向 A 股靠拢。

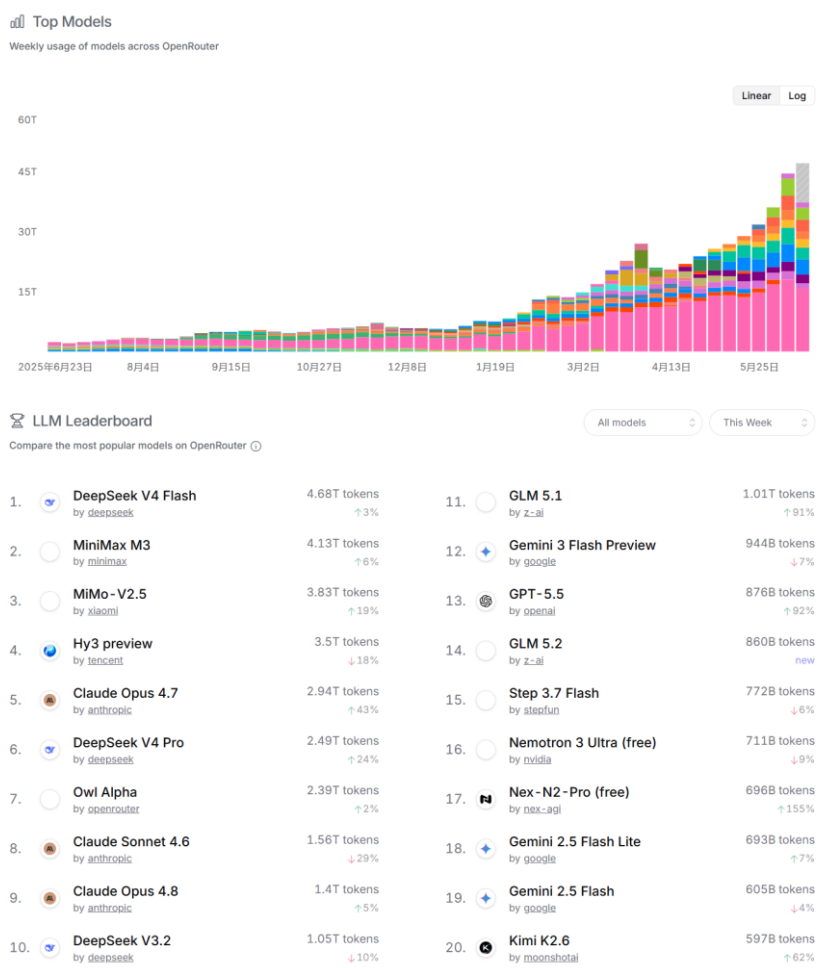
图6: 恒生沪港通 AH 溢价指数或已触底



数据来源: Wind、开源证券研究所

本周(2026.06.15-2026.06.18) OpenRouter 的 token 调用量持续提升, 创下历史新高, 其中国产模型 DeepSeekV4 依托开源生态及出色的性价比优势, 国产模型持续扩大市场影响力。

图7: OpenRouter 的 token 调用量持续提升



数据来源: OpenRouter 官网

4、投资建议

(1) AI 硬件：机柜内互联方案有望实现“由铜改光”，核心的激光器公司，以及硅光 PIC 代工厂有望受益；新发布的 RTXSpark 电脑有望带动 AIPC 的销量，PC 产业链上游配套有望受益。**受益标的：**Lumentum、TowerSemiconductor、Coherent、MicronTechnology。

(2) 先进封装：AI 芯片推动先进封装异构方案渗透，先进封装设备采购已进入密集放量期，TCB 设备作为键合环节的核心工具，将持续受益于 HBM 与 2.5D 封装的双重产能建设浪潮。**受益标的：**ASMPT。

5、风险提示

芯片研发不及预期风险：科技行业更新较快，市场竞争激烈，若产品推出不及时或不及预期，或影响企业未来竞争力和创收情况。

产能及供应链风险：若产能爬坡速度较慢，供给端受限，创收弹性无法充分释放，则相关行业产业链业绩或受到影响。

监管政策变动：科技政策及垂类行业相关政策的变动，或将影响公司增长景气度及战略决策，进一步影响公司的增长节奏。

宏观经济增长放缓：若宏观经济增长放缓影响终端消费需求、企业 IT 支出等，将影响产业链相关企业的创收能力。

地缘政治风险：全球地缘政治冲突持续，若相关国际政策出现超预期调整，或对 AI 行业供应链、技术合作与全球化落地带来限制。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为境内专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非境内专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

本研究报告的署名人员具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告，并对内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了署名人员的研究观点，所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。本报告署名人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的6~12个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中A股基准指数为沪深300指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普500或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动，过往的业绩表现不应作为其日后表现的预示。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼3层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn